

2026年7月8日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム センシング材料WG

主査 藤尾侑輝

副査 上原雅人、蔭浦泰資

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム 令和8年度 第1回 センシング材料WG講演会のご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのWG活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

本WGでは、産総研が開発する世界トップクラスのセンシング材料：窒化物薄膜(ScAlN、ScGa₂N等)、ダイヤモンド、湿式酸化物薄膜等の最新の研究開発動向(材料開発、材料特性、製造方法)、社会課題に対する応用展開に関して、産総研、大学、企業の研究者を交えた議論を行っています。近年、ScAlNやScGa₂Nなどウルツ鉱型結晶において強誘電性が発見され、強誘電体の応用展開に新しい潮流が生まれています。窒化物強誘電体材料は、半導体メモリやGa₂N-HEMTに加え、電気光学効果を活用した光通信・センシング分野への展開が期待され、産業界にとっても大きな可能性を秘めています。今回の講演会では、東京大学の小林正治教授に、強誘電体メモリを含む半導体メモリについて、最先端の研究動向をご紹介します。また、ウルツ鉱型強誘電体の研究動向についても共有し、次世代センシング技術や半導体メモリ応用に向けた議論を深める場といたし、第1回センシング材料WG講演会を開催いたします。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

敬具

記

日時：2026年7月28日(火曜日) 13:30～14:50 (13:15 受付開始)

会場：ハイブリッド開催(九州センター第2棟会議室(1109室) & Microsoft Teamsを活用したオンライン会議)

申込締切：2026年7月23日(木)

13:30～13:35	開会挨拶	センシング材料WG 副査 上原 雅人
13:35～13:55	依頼講演「センシングデバイス研究グループの半導体に関する取り組み」	産総研 センシング技術研究部門 研究グループ長 上沼 睦典
13:55～14:15	依頼講演「GaScN 強誘電体の開発」(仮題)	産総研 センシング技術研究部門 上級主任研究員 上原 雅人
14:15～14:45	招待講演「半導体メモリの最新動向」(仮題)	東京大学 工学系研究科 電気系工学専攻 生産技術研究所 教授 小林 正治 先生
14:45～14:50	閉会挨拶、事務連絡等	センシング材料WG 副査 上原 雅人

※プログラムは変更する可能性があります。

※個人情報、コンソーシアム活動及びセンシング技術研究部門の広報活動に限定して使用させていただきます。

お問い合わせ先：

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム センシング材料WG 事務局

(国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内 E-mail: M-stri-SenTePack-material-ml@aist.go.jp